

T.A Nguyen, P-Y Joubert, S. Lefebvre, S. Bontemps, Monitoring of ageing chips of semiconductor power modules using eddy current sensor, accepted 2013, Electronic Letter

T.A Nguyen, D. Labrousse, P.-Y Joubert, S. Lefebvre, S. Bontemps, Study on aluminium reconstruction and bond wire lift-off effects on current density distribution in power semiconductor dies, PCIM Europe, Nuremberg 14-16 May 2013.

T.A Nguyen, P.-Y. Joubert, S. Lefebvre and G. Chaplier, Estimation of a surface current distribution from 2D magnetic field measurements, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, Volume 39, no 1-4/2012, p.151-156.

T.A Nguyen, S. Lefebvre, P.Y Joubert, S Bontemps, Méthode de diagnostic du vieillissement de puces de puissance utilisant des capteurs à courant de Foucault, Electronique de Puissance du Futur, juillet 2012, Bordeaux.

T.A Nguyen, D. Labrousse, P.-Y Joubert, S. Lefebvre, S. Bontemps, A measure using the eddy current technique on the effect of aluminum reconstruction in power semiconductor modules, Proceeding PCIM Europe 2012, Nuremberg, 8-10 May 2012, p.757-766.

T.A Nguyen, P.-Y Joubert, S. Lefebvre, Imagerie électromagnétique sans contact de composant électronique de puissance à semi-conducteur, Instrumentation Mesure et Métrologie, Imagerie des milieux naturels et artificiels, Volume 12, no 1-2 2012, p.65-89.

T.A Nguyen, Caractérisation du vieillissement des métallisations de composants à semi-conducteurs de puissance par la méthode des courants de Foucault, Jeunes Chercheur en Génie Electrique, 13 Décembre 2011 Belfort.

T.A Nguyen, P.-Y Joubert, S. Lefebvre, G. Chaplier, Estimation d'une distribution de courant de surface grâce à des mesures-2D de champ magnétique, Assemblée Générale Interférence d'ondes - GDR, 24-26 octobre 2011, Nice, France.

T.A Nguyen, P.-Y Joubert, S. Lefebvre, G. Chaplier, Estimation of a surface current distribution from 2D magnetic field measurements, Proceedings of 15<sup>th</sup> ISEM 2011, International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, 6-9 sep.2011 Naples Italy, p.375-376.

T.A Nguyen, P.-Y. Joubert, S. Lefebvre, G. Chaplier, L. Rousseau, Study for the non-contact characterization of metallization ageing of power electronic semiconductor device using the eddy current technique, Microelectronics Reliability, Volume 51, Issue 6, June 2011, p.1127-1135.